

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二四年第四季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2025年2月13日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二四年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。

二零二四年第四季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 5.392 亿美元，同比增长 18.4%，环比增长 2.4%。
- 毛利率 11.4%，同比上升 7.4 个百分点，环比下降 0.8 个百分点。
- 母公司拥有人应占损失 2,520 万美元，上年同期及上季度分别为母公司拥有人应占溢利 3,540 万美元及 4,480 万美元，主要由于本季度为外币汇兑损失，而上年同期及上季度均为外币汇兑收益。

二零二五年第一季度指引

- 我们预计销售收入约在 5.3 亿美元至 5.5 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 9%至 11%之间。

总裁致辞

公司总裁兼执行董事白鹏先生对二零二四年第四季度及全年业绩评论道：

“很荣幸首次代表华虹半导体参与业绩发布。公司二零二四年第四季度销售收入为 5.39 亿美元，单季度毛利率为 11.4%，均符合指引。二零二四年全年实现销售收入 20.04 亿美元，全年毛利率为 10.2%。”

“对华虹半导体而言，2024 年是挑战与机遇并存的一年。市场需求复杂多变，消费领域复苏、部分新兴应用市场快速成长，带动公司图像传感器、电源管理等平台表现良好，但中高端功率器件的需求仍待改善。面对激烈的市场竞争，公司仍保持了营收与产能的稳定，整体业绩呈现逐季提升趋势。全年平均产能利用率接近 100%，在全球晶圆代工企业中处于领先水平。”

白总继续补充道：“2024 年也是继往开来的一年。公司位于无锡的第二条 12 英寸产线顺利建成投产，标志着公司在战略发展路上又迈上了一个新台阶。2025 年，华虹半导体将围绕新工艺平台和各工艺平台的迭代加强研发投入，扩大新产线的产能，围绕关键新兴产业不断变化的需求，继续与国内外重点客户建立战略合作，进一步夯实公司在特色工艺晶圆代工领域的领先地位。同时，公司也将进一步提升营运效率和加强成本控制，为股东创造出更大的价值。”

电话会议公告

日期 2025年2月13日，星期四

时间： 17:00 香港/上海时间

04:00 美国东部时间

发言人： 白鹏，总裁兼执行董事

王鼎，执行副总裁兼首席财务官

广播： 会议将在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/hgm38253> 作在线直播

(请提前注册登记)

电话直拨： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。

<https://register.vevent.com/register/Blb57631fcc7794af1af448487dae1e61e>

重要提示：在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。

网上回放： 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先进 “特色 IC + Power Discrete” 的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有 “8 英寸 + 12 英寸” 先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂, 其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	539,177	455,361	526,306	18.4 %	2.4 %
毛利	61,426	18,220	64,007	237.1 %	(4.0)%
毛利率	11.4 %	4.0 %	12.2 %	7.4	(0.8)
经营开支	(110,626)	(95,063)	(81,430)	16.4 %	35.9 %
其他(损失)/收入净额	(40,468)	87,600	51,797	(146.2)%	(178.1)%
税前(损失)/溢利	(89,668)	10,757	34,374	(933.6)%	(360.9)%
所得税开支	(6,596)	(7,210)	(11,461)	(8.5)%	(42.4)%
期内(损失)/溢利	(96,264)	3,547	22,913	(2,814.0)%	(520.1)%
净利润率	(17.9)%	0.8 %	4.4 %	(18.7)	(22.3)
以下各方应占:					
母公司拥有人	(25,199)	35,386	44,816	(171.2)%	(156.2)%
非控股权益	(71,065)	(31,839)	(21,903)	123.2 %	224.5 %
持有人应占每股盈利					
基本	(0.015)	0.021	0.026	(171.4)%	(157.7)%
摊薄	(0.015)	0.021	0.026	(171.4)%	(157.7)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,213	951	1,200	27.5 %	1.1 %
产能利用率 ¹	103.2 %	84.1 %	105.3 %	19.1	(2.1)
净资产收益率 ²	(1.6)%	2.4 %	2.8 %	(4.0)	(4.4)

二零二四年第四季度

- 销售收入 5.392 亿美元, 同比增长 18.4%, 主要得益于付运晶圆数量上升, 部分被平均销售价格下降所抵消; 环比增长 2.4%, 主要得益于平均销售价格及付运晶圆数量上升。
- 毛利率 11.4%, 同比上升 7.4 个百分点, 主要得益于产能利用率同比大幅提升; 环比下降 0.8 个百分点。
- 经营开支 1.106 亿美元, 同比和环比分别上升 16.4%和 35.9%, 主要由于研发工程片开支上升, 及新工厂的运营费用上升。
- 其他损失净额 4,050 万美元, 上年同期及上季度分别为其他收入净额 8,760 万美元及 5,180 万美元, 主要由于本季度为外币汇兑损失, 而上年同期及上季度为外币汇兑收益, 以及本季度政府补贴减少。
- 所得税开支 660 万美元, 同比下降 8.5%, 环比下降 42.4%。
- 期内损失 9,630 万美元, 上年同期及上季度分别为期内溢利 350 万美元及 2,290 万美元。
- 母公司拥有人应占损失 2,520 万美元, 上年同期及上季度分别为母公司拥有人应占利润 3,540 万美元及 4,480 万美元。
- 基本每股盈利-0.015 美元, 上年同期为 0.021 美元, 上季度为 0.026 美元。
- 净资产收益率(年化) -1.6%, 同比下降 4.0 个百分点, 环比下降 4.4 个百分点。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二四年 (未经审核)	二零二三年 (已审核)	同比
销售收入	2,003,993	2,286,113	(12.3)%
毛利	205,128	487,096	(57.9)%
毛利率	10.2%	21.3%	(11.1)
经营开支	(360,904)	(333,057)	8.4 %
其他收入净额	21,984	19,540	12.5 %
税前(损失)/溢利	(133,792)	173,579	(177.1)%
所得税开支	(6,593)	(47,154)	(86.0)%
年内(损失)/溢利	(140,385)	126,425	(211.0)%
净利润率	(7.0)%	5.5 %	(12.5)
以下各方应占:			
母公司拥有人	58,108	280,034	(79.2)%
非控股权益	(198,493)	(153,609)	29.2 %
持有人应占每股盈利			
基本	0.034	0.189	(82.0)%
摊薄	0.034	0.188	(81.9)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	4,545	4,103	10.8 %
产能利用率	99.5 %	94.3 %	5.2
净资产收益率	0.9 %	6.3 %	(5.4)

二零二四年度

- 销售收入 20.040 亿美元, 较上年度下降 12.3%, 主要由于平均销售价格下降, 部分被付运晶圆数量上升所抵消。
- 毛利率 10.2%, 较上年度下降 11.1 个百分点, 主要由于平均销售价格下降及折旧成本上升。
- 经营开支 3.609 亿美元, 较上年度上升 8.4%, 主要由于研发开支上升, 及新工厂的运营费用上升。
- 其他收入净额 2,200 万美元, 较上年度上升 12.5%, 主要由于利息收入上升, 部分被政府补贴下降所抵消。
- 年内损失 1.404 亿美元, 上年度为年内溢利 1.264 亿美元。
- 母公司拥有人应占溢利 5,810 万美元, 上年度为 2.800 亿美元。
- 基本每股盈利 0.034 美元, 上年度为 0.189 美元。
- 净资产收益率 0.9%, 上年度为 6.3%。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	512,677	95.1 %	436,375	95.8 %	76,302	17.5 %
其他	26,500	4.9 %	18,986	4.2 %	7,514	39.6 %
销售收入总额	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度 95.1% 的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	252,234	46.8 %	250,743	55.1 %	1,491	0.6 %
12 吋晶圆	286,943	53.2 %	204,618	44.9 %	82,325	40.2 %
销售收入总额	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.522 亿美元及 2.869 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	450,782	83.7 %	366,508	80.5 %	84,274	23.0 %
北美 ⁴	48,120	8.9 %	36,811	8.1 %	11,309	30.7 %
亚洲 ⁵	23,878	4.4 %	30,176	6.6 %	(6,298)	(20.9)%
欧洲	14,258	2.6 %	18,475	4.1 %	(4,217)	(22.8)%
日本 ⁶	2,139	0.4 %	3,391	0.7 %	(1,252)	(36.9)%
销售收入总额	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度来自于中国的销售收入 4.508 亿美元，占销售收入总额的 83.7%，同比增长 23.0%，主要得益于闪存、MCU、超级结、逻辑及通用 MOSFET 产品的需求增加。
- 本季度来自于北美的销售收入 4,810 万美元，同比增长 30.7%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度来自于亚洲的销售收入 2,390 万美元，同比下降 20.9%，主要由于超级结、逻辑、及通用 MOSFET 产品的需求下降。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,430 万美元，同比下降 22.8%，主要由于通用 MOSFET 产品的需求下降。
- 本季度来自于日本的销售收入 210 万美元，同比下降 36.9%，主要由于超级结产品的需求下降。

³包括中国大陆及中国香港。

⁴包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵不包括中国及日本。

⁶包括于 2013 年由一家总部位于美国的公司所收购的一家主要日本客户。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二四年	二零二四年	二零二三年	二零二三年	同比	同比
	第四季度	第四季度	第四季度	第四季度		
	千美元	%	千美元	%		
	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)	千美元	%
嵌入式非易失性存储器	137,184	25.4 %	112,026	24.6 %	25,158	22.5 %
独立式非易失性存储器	46,056	8.5 %	14,753	3.2 %	31,303	212.2 %
分立器件	164,954	30.7 %	182,377	40.2 %	(17,423)	(9.6)%
逻辑及射频	67,491	12.5 %	56,227	12.3 %	11,264	20.0 %
模拟与电源管理	122,618	22.7 %	89,448	19.6 %	33,170	37.1 %
其他	874	0.2 %	530	0.1 %	344	64.9 %
销售收入总额	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.372 亿美元，同比增长 22.5%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 4,610 万美元，同比增长 212.2%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- 本季度分立器件销售收入 1.650 亿美元，同比下降 9.6%，主要由于 IGBT 产品的需求下降，部分被通用 MOSFET 及超级结产品需求增加所抵消。
- 本季度逻辑及射频销售收入 6,750 万美元，同比增长 20.0%，主要得益于逻辑及 CIS 产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.226 亿美元，同比增长 37.1%，主要得益于其他电源管理及模拟产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
55nm 及 65nm	129,033	23.9 %	60,920	13.4 %	68,113	111.8 %
90nm 及 95nm	106,414	19.7 %	82,552	18.1 %	23,862	28.9 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	70,233	13.0 %	73,762	16.2 %	(3,529)	(4.8)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	31,328	5.8 %	31,049	6.8 %	279	0.9 %
0.25 μ m	2,724	0.5 %	5,357	1.2 %	(2,633)	(49.2)%
0.35 μ m 及以上	199,445	37.1 %	201,721	44.3 %	(2,276)	(1.1)%
销售收入总额	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工艺技术节点的销售收入 1.290 亿美元，同比增长 111.8%，主要得益于闪存及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 1.064 亿美元，同比增长 28.9%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工艺技术节点的销售收入 7,020 万美元，同比下降 4.8%，主要由于智能卡芯片及逻辑产品的需求下降。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工艺技术节点的销售收入 3,130 万美元，同比增长 0.9%。
- 本季度 0.25 μ m 工艺技术节点的销售收入 270 万美元，同比下降 49.2%，主要由于 RF 及逻辑产品的需求下降。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工艺技术节点的销售收入 1.994 亿美元，同比下降 1.1%，主要由于 IGBT 产品的需求下降，部分被智能卡芯片、通用 MOSFET、超级结、其他电源管理及模拟产品的需求增加所抵消。

销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
电子消费品	344,594	63.9 %	252,508	55.4 %	92,086	36.5 %
工业及汽车	124,037	23.0 %	138,628	30.4 %	(14,591)	(10.5)%
通讯	64,619	12.0 %	53,973	11.9 %	10,646	19.7 %
计算机	5,927	1.1 %	10,252	2.3 %	(4,325)	(42.2)%
销售收入总额	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度电子消费品作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 3.446 亿美元，占销售收入总额的 63.9%，同比增长 36.5%，主要得益于闪存、其他电源管理、超级结、MCU、通用 MOSFET、及逻辑产品的需求增加。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.240 亿美元，同比下降 10.5%，主要由于 IGBT 产品需求下降，部分被 MCU 及其他电源管理产品的需求增加所抵消。
- 本季度通讯产品销售收入 6,460 万美元，同比增长 19.7%，主要得益于模拟、CIS、其他电源管理及智能卡芯片产品的需求增加。
- 本季度计算机产品销售收入 590 万美元，同比下降 42.2%，主要由于通用 MOSFET、超级结及 MCU 产品的需求下降。

产能⁷及产能利用率

晶圆厂(折合千片晶圆)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)
产能 (200mm)	178	178	178
产能 (300mm)	95	95	95
合计产能(折合 8 吋千片晶圆)	391	391	391
产能利用率 (200mm)	105.8%	91.0%	113.0%
产能利用率 (300mm)	100.9%	77.5%	98.5%
总体产能利用率	103.2%	84.1%	105.3%

- 本季度末月产能 391,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 103.2%，较上季度下降 2.1 个百分点。

⁷ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,213	951	1,200	27.5 %	1.1 %

- 本季度付运晶圆 1,213,000 片，同比上升 27.5%，环比上升 1.1%。

经营开支分析

以千美元计	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,617	2,684	2,241	(2.5)%	16.8 %
管理费用 ⁸	108,009	92,379	79,189	16.9 %	36.4 %
经营开支	110,626	95,063	81,430	16.4 %	35.9 %

- 经营开支 1.106 亿美元，同比和环比分别上升 16.4%和 35.9%，主要由于研发工程片开支上升，及新工厂的运营费用上升。

其他(损失)/收入净额

以千美元计	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,481	3,447	3,612	1.0 %	(3.6)%
利息收入	20,450	20,182	26,710	1.3 %	(23.4)%
汇兑(损失)/收益	(48,664)	27,041	29,270	(280.0)%	(266.3)%
分占联营公司(损失)/溢利	(433)	7,136	1,087	(106.1)%	(139.8)%
财务费用	(20,406)	(19,540)	(27,275)	4.4 %	(25.2)%
政府补贴	4,705	51,387	18,535	(90.8)%	(74.6)%
其他	399	(2,053)	(142)	(119.4)%	(381.0)%
其他(损失)/收入净额	(40,468)	87,600	51,797	(146.2)%	(178.1)%

- 其他损失净额 4,050 万美元，上年同期及上季度分别为其他收入净额 8,760 万美元及 5,180 万美元，主要由于本季度为外币汇兑损失，而上年同期及上季度为外币汇兑收益，以及本季度政府补贴减少。

⁸管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金流量分析

以千美元计	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得/(用)现金流量净额	308,108	196,546	(26,838)	56.8 %	(1,248.0)%
投资活动所用现金流量净额	(1,444,013)	(301,916)	(715,920)	378.3 %	101.7 %
融资活动所(用)/得现金流量净额	(50,929)	642,297	(5,007)	(107.9)%	917.2 %
外汇汇率变动影响净额	(120,783)	58,753	90,648	(305.6)%	(233.2)%
现金及现金等价物变动影响净额	(1,307,617)	595,680	(657,117)	(319.5)%	99.0 %

- 本季度经营活动所得现金流量净额 3.081 亿美元，同比上升 56.8%，主要由于本季度客户收款增加。
- 投资活动所用现金流量净额 14.440 亿美元，其中包括固定资产投资支出 15.057 亿美元，部分被收到政府对设备的补助 4,120 万美元，利息收入 1,790 万美元，及处置其他权益工具投资 260 万美元所抵消。
- 融资活动所用现金流量净额 5,090 万美元，其中偿还银行借款 9,150 万美元，支付利息 5,050 万美元，及支付租赁负债 40 万美元，部分被提取银行借款 8,450 万美元，收到政府对财务费用的补助 550 万美元，及员工行权发行股份收到 150 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于十二月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)
资产总额	12,415,108	13,082,459
负债总额	3,508,489	3,867,040
所有者权益总额	8,906,619	9,215,419
资产负债率 ⁹	28.3%	29.6%

资本开支

以千美元计	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)
华虹 8 吋	21,159	28,607
华虹无锡	43,833	87,754
华虹制造	1,440,717	617,708
合计	1,505,709	734,069

- 本季度资本开支 15.057 亿美元，其中 14.407 亿美元用于华虹制造，4,380 万美元用于华虹无锡，及 2,110 万美元用于华虹 8 吋。

⁹资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于十二月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)
发展中物业	221,905	225,711
存货	467,060	487,480
贸易应收款项及应收票据	270,461	268,186
预付款项、其他应收款项及其他资产	363,997	269,191
应收关联方款项	18,324	25,426
已冻结存款及定期存款	31,624	32,443
现金及现金等价物	4,459,132	5,766,749
流动资产总额	5,832,503	7,075,186
贸易应付款项	298,372	273,352
其他应付款项及暂估费用	880,447	1,237,992
计息银行借款	280,704	262,296
租赁负债	4,912	4,451
政府补助	57,563	40,072
应付关联方款项	9,125	10,167
应付所得税	31,115	26,494
流动负债总额	1,562,238	1,854,824
净营运资金	4,270,265	5,220,362
速动比率	3.3x	3.4x
流动比率	3.7x	3.8x
贸易应收款项及应收票据周转天数	45	47
存货周转天数	90	92

- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 2.692 亿美元上升至本季度末的 3.640 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 应收关联方款项由上季度末的 2,540 万美元下降至本季度末的 1,830 万美元，主要由于本季度收到一家关联方的租赁款。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 12.380 亿美元下降至本季度末的 8.804 亿美元，主要由于本季度支付应付资本开支。
- 应付所得税由上季度末的 2,650 万美元上升至本季度末的 3,110 万美元，主要由于本季度计提所得税开支。
- 净营运资金本季度末 42.703 亿美元，流动比率 3.7。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 45 天。
- 存货周转天数 90 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于十二月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)
销售收入	539,177	455,361	526,306
销售成本	(477,751)	(437,141)	(462,299)
毛利	61,426	18,220	64,007
其他收入及收益	29,155	100,442	78,092
投资物业的公平值(损失)/收益	(39)	103	-
销售及分销费用	(2,617)	(2,684)	(2,241)
管理费用	(108,009)	(92,379)	(79,189)
其他费用	(48,745)	(541)	(107)
财务费用	(20,406)	(19,540)	(27,275)
分占联营公司(损失)/溢利	(433)	7,136	1,087
税前(损失)/溢利	(89,668)	10,757	34,374
所得税开支	(6,596)	(7,210)	(11,461)
期内(损失)/溢利	(96,264)	3,547	22,913
以下各方应占:			
母公司拥有人	(25,199)	35,386	44,816
非控股权益	(71,065)	(31,839)	(21,903)
持有人应占每股盈利			
基本	(0.015)	0.021	0.026
摊薄	(0.015)	0.021	0.026
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,718,222,223	1,716,439,808	1,717,612,830
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,724,086,667	1,720,215,394	1,721,402,553

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	二零二四年 (未经审核)	二零二三年 (已审核)
销售收入	2,003,993	2,286,113
销售成本	(1,798,865)	(1,799,017)
毛利	205,128	487,096
其他收入及收益	149,072	144,370
投资物业的公平值(损失)/收益	(39)	103
销售及分销费用	(9,628)	(10,189)
管理费用	(351,276)	(322,868)
其他费用	(33,395)	(33,666)
财务费用	(97,113)	(100,497)
分占联营公司溢利	3,459	9,230
税前(损失)/溢利	(133,792)	173,579
所得税开支	(6,593)	(47,154)
期内(损失)/溢利	(140,385)	126,425
以下各方应占：		
母公司拥有人	58,108	280,034
非控股权益	(198,493)	(153,609)
持有人应占每股盈利		
基本	0.034	0.189
摊薄	0.034	0.188
用于计算持有人应占每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数	1,717,346,778	1,477,978,482
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数	1,721,085,846	1,486,531,954

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于十二月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二三年 (已审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	5,859,117	5,198,989	3,519,292
投资物业	164,153	168,433	166,643
使用权资产	77,761	81,372	78,545
无形资产	31,456	38,897	49,827
于联营公司的投资	139,799	144,534	139,099
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	289,311	290,857	270,506
长期预付款项	21,008	83,396	149,953
递延税项资产	-	795	-
非流动资产总额	6,582,605	6,007,273	4,373,865
流动资产			
发展中物业	221,905	225,711	178,828
存货	467,060	487,480	449,749
贸易应收款项及应收票据	270,461	268,186	278,669
预付款项、其他应收款项及其他资产	363,997	269,191	33,821
应收关联方款项	18,324	25,426	11,219
已冻结存款及定期存款	31,624	32,443	32,088
现金及现金等价物	4,459,132	5,766,749	5,585,181
流动资产总额	5,832,503	7,075,186	6,569,555
流动负债			
贸易应付款项	298,372	273,352	235,410
其他应付款项及暂估费用	880,447	1,237,992	430,478
计息银行借款	280,704	262,296	193,035
租赁负债	4,912	4,451	3,076
政府补助	57,563	40,072	35,017
应付关联方款项	9,125	10,167	13,876
应付所得税	31,115	26,494	61,495
流动负债总额	1,562,238	1,854,824	972,387
流动资产净额	4,270,265	5,220,362	5,597,168
总资产减流动负债	10,852,870	11,227,635	9,971,033
非流动负债			
计息银行借款	1,917,235	1,983,494	1,906,526
租赁负债	18,068	19,334	19,129
递延税项负债	10,948	9,388	30,834
非流动负债总额	1,946,251	2,012,216	1,956,489
净资产	8,906,619	9,215,419	8,014,544
权益和负债权益			
股本	4,938,457	4,936,472	4,933,559
储备	1,308,569	1,478,303	1,367,436
本公司拥有人应占权益	6,247,026	6,414,775	6,300,995
非控股权益	2,659,593	2,800,644	1,713,549
权益总额	8,906,619	9,215,419	8,014,544

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于十二月三十一日	于十二月三十一日	于九月三十日
	二零二四年 (未经审核)	二零二三年 (未经审核)	二零二四年 (未经审核)
经营活动现金流量：			
税前(亏损)/溢利	(89,668)	10,757	34,374
折旧及摊销	142,306	129,135	143,557
应占联营公司损失/(溢利)	433	(7,136)	(1,087)
营运资金的变动及其它	255,037	63,790	(203,682)
经营活动所得/(用)现金流量净额	308,108	196,546	(26,838)
投资活动现金流量：			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(1,505,709)	(331,369)	(734,069)
收到政府对设备的补助	41,149	11,692	-
其他投资活动所得现金流量	20,547	17,761	18,149
投资活动所用现金流量净额	(1,444,013)	(301,916)	(715,920)
融资活动现金流量：			
非控股权益资本注资	-	491,723	-
提取银行贷款	84,551	246,620	2,287
发行股份所得收益	1,478	1,407	1,471
偿还银行贷款	(91,518)	(54,942)	(4,476)
已付利息	(50,498)	(45,234)	(3,283)
向股东支付股息	-	-	(7,371)
已抵押存款减少	-	-	7,369
支付租赁负债	(401)	(274)	(1,004)
收到政府对财务费用的补助	5,459	2,997	-
融资活动所(用)/得现金流量净额	(50,929)	642,297	(5,007)
现金及现金等价物(减少)/增加净额	(1,186,834)	536,927	(747,765)
外汇汇率变动影响净额	5,766,749	58,753	90,648
期初现金及现金等价物	(120,783)	4,989,501	6,423,866
期末现金及现金等价物	4,459,132	5,585,181	5,766,749

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	二零二四年 (未经审核)	二零二三年 (已审核)
经营活动现金流量：		
税前(亏损)/溢利	(133,792)	173,579
折旧及摊销	555,832	500,439
应占联营公司溢利	(3,459)	(9,230)
营运资金的变动及其它	239	(23,093)
经营活动所得现金流量净额	418,820	641,695
投资活动现金流量：		
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(2,739,182)	(906,607)
购买其他权益工具	(17,618)	-
收到政府对设备的补助	41,149	11,692
其他投资活动所得现金流量	84,794	61,603
投资活动所用现金流量净额	(2,630,857)	(833,312)
融资活动现金流量：		
发行股份所得收益	3,642	2,941,945
非控股权益资本注资	1,181,880	787,920
提取银行贷款	289,285	615,415
偿还银行贷款	(183,524)	(422,120)
已付利息	(105,736)	(106,570)
向股东支付股息	(36,247)	-
已抵押存款增加	-	(31,214)
支付租赁负债	(4,634)	(4,597)
其他融资活动所用现金流量	5,459	967
融资活动所得现金流量净额	1,150,125	3,781,746
现金及现金等价物(减少)/增加净额	(1,061,912)	3,590,129
外汇汇率变动影响净额	5,585,181	(13,713)
期初现金及现金等价物	(64,137)	2,008,765
期末现金及现金等价物	4,459,132	5,585,181

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

唐均君(董事长)
白鹏(总裁)

非执行董事

叶峻
孙国栋
周利民
熊承艳

独立非执行董事

张祖同
王桂壖太平绅士
封松林

承董事会命

华虹半导体有限公司
唐均君
董事长兼执行董事

中国 香港

二零二五年二月十三日